

～価格競争力に自信あり～

# ガラスハーメチック(気密端子・コネクタ)への 高精度な金めっき 量産技術



## <PR>

### ①低コストの量産処理が可能です

電解めっきのベースとリードピンの膜厚差が小さい(膜厚比 約1:1.5)  
量産バッチでも固体ごとの膜厚ばらつき幅を小さくできます  
形状・ピン径に合わせ、通電用ダミーを最小数で済むようカスタムします

### ②ワイヤーボンディングのための、専用金めっき被膜

長年の実績から、専用のめっき液組成で対応

### ③変形・絡まりやすい、多ピンでリードが長いピンもOK

様々なめっき治具を用意しており、製品へのストレスが  
少ないめっきができます

### ④扱いが難しい小型品(ステム径φ2・ピン径φ0.25)も対応OK

### ⑤セラミックベースの、ピンのみめっきOK

## <用途>

ステム(光素子用、各種センサ・トランジスタ・IC 等)  
コネクタ(高電圧・高電流・耐水・耐圧用 等)



## <めっき仕様>

### ニッケルめっき 下地or仕上げ

電解 ニッケルめっき(Ni) : 光沢・無光沢  
無電解 ニッケルめっき(Ni-p)

### 金めっき 仕上げ:軟質めっき

### (ワイヤーボンディング専用めっき)

電解 金めっき(Au) : 無光沢  
無電解 金めっき(Au) : 無光沢

～不可能への挑戦～

株式会社 友電舎  
大阪市此花区常吉2丁目4番8号  
TEL:06-6465-1663  
Mail:joho1@ydn.co.jp  
URL:http://www.ydn.co.jp

